

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6701A/BxxxPR-G

標準質量: 57 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.617	シリコン	10800	7440-21-3
リードフレーム	24.392	銅	427900	7440-50-8
	0.016	錫	300	7440-31-5
	0.218	銀	3800	7440-22-4
ダイアタッチ	0.126	銀	2200	7440-22-4
	0.032	エポキシ	600	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	500	7440-57-5
封止樹脂	26.926	溶融シリカ	472400	60676-86-0
	2.197	エポキシ樹脂	38500	—
	1.586	フェノール樹脂	27800	—
	0.430	金属水酸化物	7500	—
端子メッキ	0.430	錫	7500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。